

2024年12月期 中間期 決算説明資料

株式会社レゾナック・ホールディングス

取締役 常務執行役員 CFO

染宮 秀樹

2024年8月8日

RESONAC

- ① 2024年中間期決算は、前年同期比増収・増益
- ② 2024年通期業績予想は、前年同期比増収・増益
前回公表値からは上方修正

目次

1. 2024年12月期 中間期決算
2. 2024年12月期 業績予想

連結業績の概要 (前年同期比)

(億円)

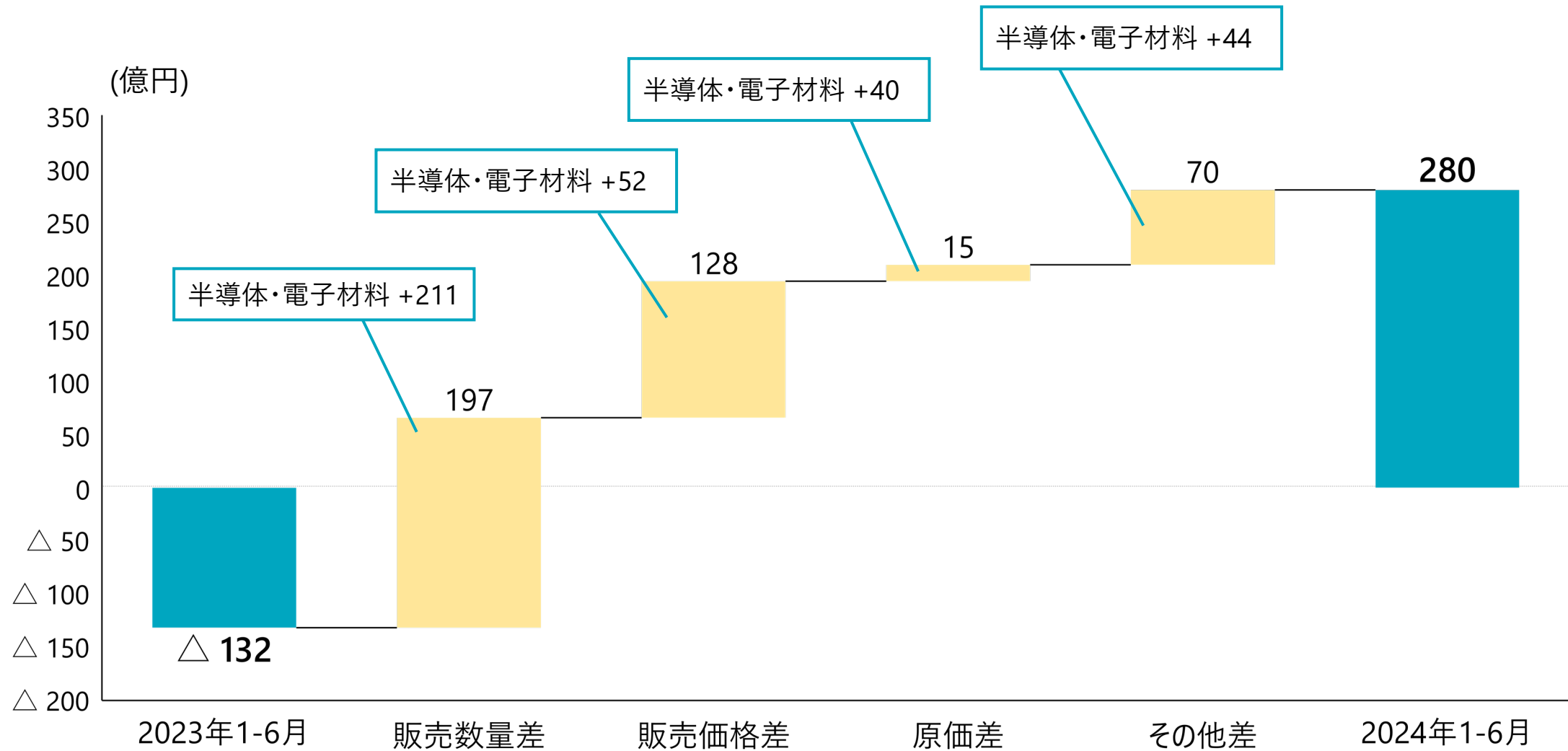
項目	2023年 1-6月	2024年 1-6月	増減
売上高	6,161	6,685	524
営業利益	△ 132	280	411
営業外損益	18	25	7
経常利益	△ 114	305	418
特別損益	△ 36	176	213
税金等調整前中間純利益	△ 150	481	631
中間純利益	△ 187	384	571
親会社株主に帰属する中間純利益	△ 198	384	583
EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん等償却額)	410	838	427
対売上EBITDA _(%)	6.7%	12.5%	5.9p

参考 継続事業ベース※ (億円)

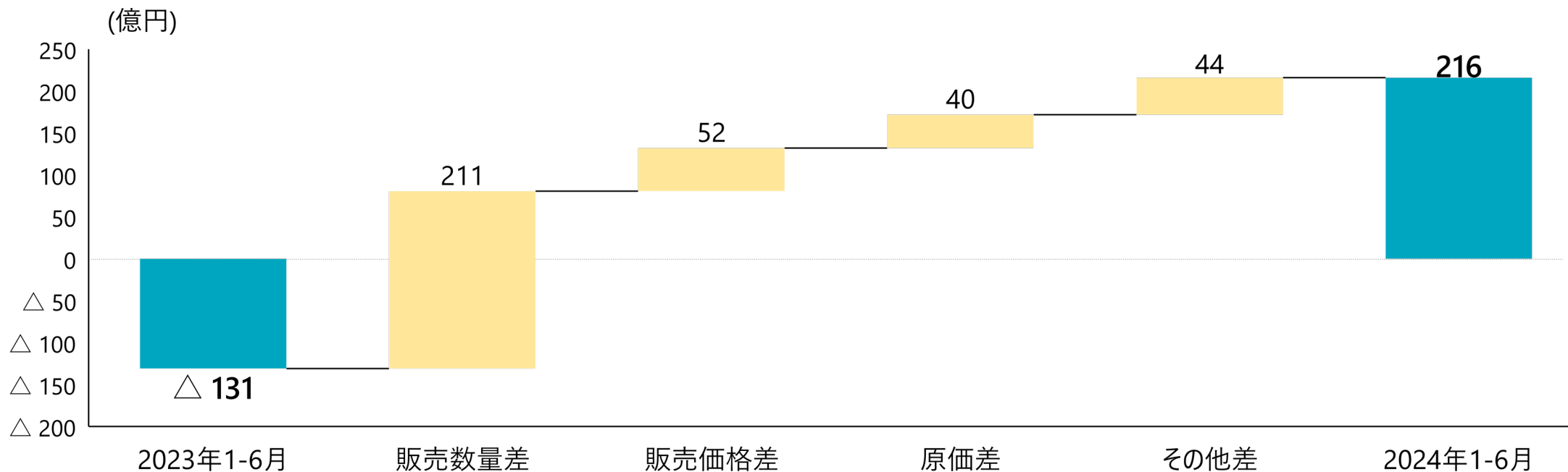
	2023年 1-6月	2024年 1-6月	増減
売上高	6,096	6,685	589
営業利益	△ 135	280	415
EBITDA	403	838	435
対売上 EBITDA _(%)	6.6%	12.5%	5.9p

※ 事業譲渡した診断薬事業を除いた参考値 (監査対象外)

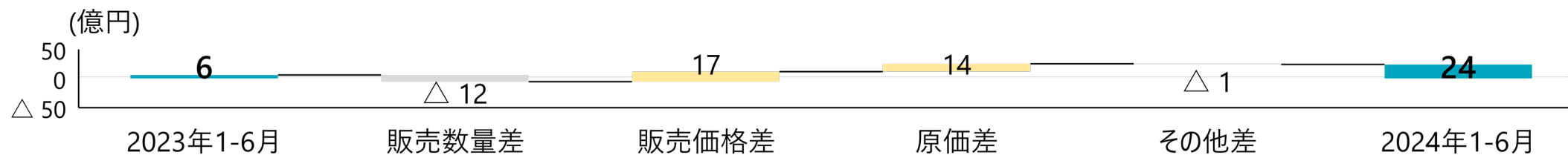
連結営業利益差異内訳 (前年同期比)



半導体・電子材料

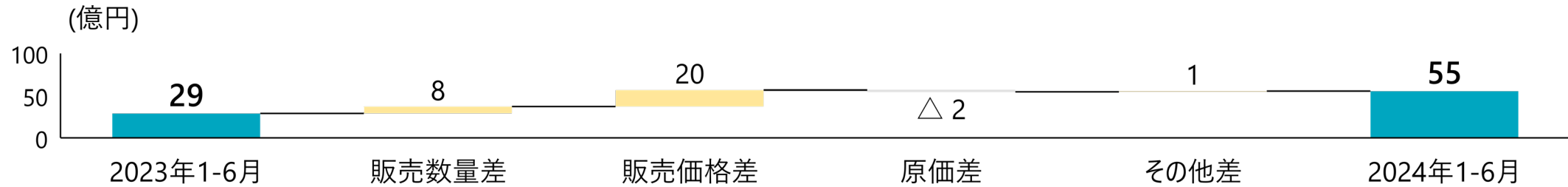


モビリティ*

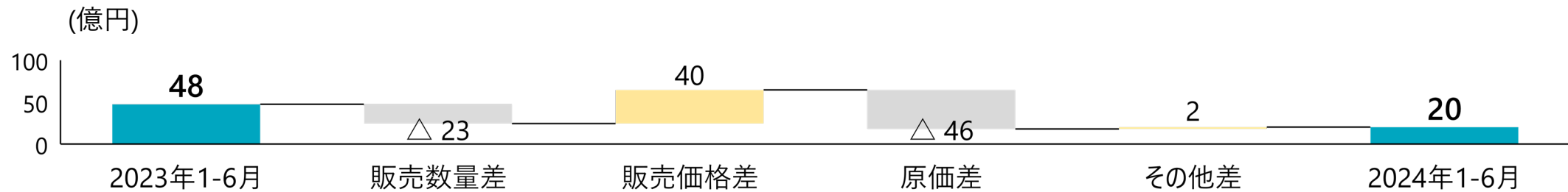


* アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

イノベーション材料[※]



ケミカル



※ アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

セグメント別売上高・営業利益・EBITDA (前年同期比)

(億円)

セグメント		2023年 1-6月※	2024年 1-6月	増減	増減率
半導体・電子材料	売上高	1,534	2,096	562	37%
	営業利益	△ 131	216	347	-
	EBITDA	133	486	354	267%
モビリティ	売上高	1,039	1,080	41	4%
	営業利益	6	24	18	292%
	EBITDA	107	129	22	21%
イノベーション材料	売上高	436	470	35	8%
	営業利益	29	55	26	92%
	EBITDA	63	89	26	42%
ケミカル	売上高	2,549	2,454	△ 95	△ 4%
	営業利益	48	20	△ 27	△ 57%
	EBITDA	134	114	△ 20	△ 15%
その他・調整額	売上高	603	585	△ 18	△ 3%
	営業利益	△ 83	△ 36	47	-
	EBITDA	△ 26	20	45	-
合計	売上高	6,161	6,685	524	9%
	営業利益	△ 132	280	411	-
	EBITDA	410	838	427	104%

※ アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

セグメント別サマリー (半導体・電子材料) (前年同期比)

(億円)

項目	2023年 1-6月	2024年 1-6月	増減	増減率	業績概況
売上高	1,534	2,096	562	37%	前年同期からの緩やかな需要回復により販売数量が増加し、増収増益。 ・半導体前工程材料:円安の進行もあり増収 ・半導体後工程材料:半導体市況の回復による販売数量増で全ての主要製品で増収 ・デバイスソリューション: HDメディアはデータセンター向け需要の回復による販売数量増で大幅増収。 SiCエピタキシャルウェハーも販売数量増で増収
半導体前工程材料	395	420	25	6%	
半導体後工程材料	727	979	251	35%	
デバイスソリューション	258	489	231	90%	
その他	154	208	54	35%	
営業利益	△ 131	216	347	-	
EBITDA	133	486	354	267%	
対売上EBITDA _(%)	8.6%	23.2%	14.6p	-	

主要製品

- 半導体前工程材料: 電子材料用高純度ガス、半導体回路平坦化用研磨材料(CMPスラリー)
- 半導体後工程材料: エポキシ封止材、ダイボンディング材料、銅張積層板、感光性フィルム、感光性ソルダーレジスト
- デバイスソリューション: HDメディア、SiCエピタキシャルウェハー、化合物半導体(LED)

セグメント別サマリー (モビリティ) (前年同期比)

(億円)

項目	2023年 1-6月※	2024年 1-6月	増減	増減率	業績概況
売上高	1,039	1,080	41	4%	
自動車部品	894	888	△ 6	△ 1%	自動車生産の回復や新規車種向け製品立上等数量増等により、増収増益
リチウムイオン電池材料	147	170	24	16%	・自動車部品: タイの情勢等を背景とした需要の低迷の影響を受けた一方、自動車生産の回復や新規車種向け製品立上等により、前期並み
その他	△ 1	22	23	-	
営業利益	6	24	18	292%	・リチウムイオン電池材料: 民生需要の低迷により、アルミラミネートフィルム(SPALF)は減収となったものの、EV向けで数量が増加し、カーボン負極材は増収、正負極用導電助剤は前期並み
EBITDA	107	129	22	21%	
対売上EBITDA _(%)	10.3%	12.0%	1.7p	-	

主要製品

- 自動車部品: 樹脂成形品、摩擦材、粉末冶金製品、アルミ機能部材
- リチウムイオン電池材料: アルミラミネートフィルム(SPALF)、正負極用導電助剤、カーボン負極材

※ アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

セグメント別サマリー (イノベーション材料) (前年同期比)

(億円)

項目	2023年 1-6月※	2024年 1-6月	増減	増減率	業績概況
売上高	436	470	35	8%	原材料価格の高騰を製品販売価格に転嫁したことや 販売数量増により増収、前年同期の価格転嫁タイムラ グ要因が解消され増益。
営業利益	29	55	26	92%	
EBITDA	63	89	26	42%	
対売上EBITDA _(%)	14.4%	18.9%	4.5p	-	

主要製品

- 樹脂材料、機能性化学品、コーティング材料、セラミックス

※ アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

セグメント別サマリー (ケミカル) (前年同期比)

(億円)

項目	2023年 1-6月	2024年 1-6月	増減	増減率	業績概況
売上高	2,549	2,454	△ 95	△ 4%	・石油化学: 誘導品定修の影響で販売数量減少も、ナフサ価格上昇に伴う販売単価が上昇し、増収増益 ・化学品: 売上高は前年同期並み、一部製品の原料高により減益 ・黒鉛電極: 市況低迷により販売数量の減少及び販売単価が下落し減収減益
石油化学	1,535	1,559	24	2%	
化学品	407	404	△ 3	△ 1%	
黒鉛電極	599	490	△ 109	△ 18%	
その他	8	1	△ 7	△ 83%	
営業利益	48	20	△ 27	△ 57%	
EBITDA	134	114	△ 20	△ 15%	
対売上EBITDA _(%)	5.2%	4.6%	△ 0.6p	-	

主要製品

- 石油化学: オレフィン、有機化学品
- 化学品: 基礎化学品、産業ガス

営業外損益内訳

(億円)

項目	2023年 1-6月	2024年 1-6月	増減
金融収支	△ 56	△ 51	5
持分法投資損益	19	27	7
為替差益	72	66	△ 6
その他	△ 17	△ 17	0
営業外損益 計	18	25	7

特別損益内訳

(億円)

項目	2023年 1-6月	2024年 1-6月	増減
固定資産売却益	15	202	187
固定資産除売却損	△ 22	△ 20	2
減損損失	△ 30	△ 14	16
その他	0	8	8
特別損益 計	△ 36	176	213

連結貸借対照表

(億円)

資産	2023年 12月末	2024年 6月末	増減	負債・純資産	2023年 12月末	2024年 6月末	増減
現預金	1,903	2,384	481	営業債務	1,774	1,772	△ 2
営業債権	2,661	2,791	130	有利子負債	10,165	10,248	82
たな卸資産	2,252	2,378	126	その他負債	2,594	2,673	80
その他流動資産	703	724	21	負債計	14,533	14,693	160
流動資産計	7,519	8,277	757	株主資本計	4,160	4,059	△ 101
有形固定資産計	6,786	7,018	232	(内、利益剰余金)	1,373	1,289	△ 84
無形固定資産計	4,706	4,467	△ 239	その他の包括利益累計額計	1,369	2,132	763
(内、のれん)	2,852	2,771	△ 81	(内、土地再評価差額金)	261	611	350
(内、その他無形固定資産)	1,854	1,696	△ 158	(内、為替換算調整勘定)	992	1,431	439
投資その他の資産計	1,309	1,386	78	非支配株主持分	258	264	5
固定資産計	12,800	12,871	71	純資産計	5,787	6,454	668
資産合計	20,320	21,148	828	負債・純資産合計	20,320	21,148	828

主要指標

ネットD/Eレシオ (倍) ^{※1}	1.00	0.86	△ 0.14	自己資本比率 (%) ^{※2}	27.2	29.3	2.1p
-----------------------------	------	------	--------	--------------------------	------	------	------

※1 {(借入金 + コマーシャルペーパー + 社債 + リース債務) - 現金及び預金 - 劣後ローン × 50%} ÷ (自己資本 + 劣後ローン × 50%)

劣後ローン(借入金に含まれる)の50%の資本性は、2020年4月27日付の(株)日本格付研究所の格付に基づく

※2 {(純資産計 - 非支配株主持分)/負債・純資産合計} × 100

目次

1. 2024年12月期 中間期決算
2. 2024年12月期 業績予想

2024年連結業績予想

項目	2023年 実績(A)	2024年 今回予想(C) ^{※1}	前年比 (C)-(A)	2024年 前回予想(B) ^{※2}	前回予想比 (C)-(B)
売上高	12,889	13,920	1,031	13,600	320
営業利益	△ 38	610	648	470	140
営業外損益	△ 110	△ 100	10	△ 150	50
経常利益	△ 148	510	658	320	190
特別損益	△ 114	△ 10	104	△ 40	30
税金等調整前当期純利益	△ 262	500	762	280	220
当期純利益	△ 180	350	530	260	90
親会社株主に帰属する当期純利益	△ 190	345	535	250	95
EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん等償却額)	1,057	1,713	656		
対売上EBITDA _(%)	8.2%	12.3%	4.1p		
ROIC ^{※3}	0.5%	3.0%	2.5p		
ネットD/Eレシオ _(倍) ^{※4}	1.00	0.93	△ 0.07		
1株当たり当期純利益	△104円65銭	190円86銭	295.51	138円31銭	52.56
1株当たり配当金	65円	65円	-	65円	-

(億円)

※1 2024年8月8日公表

※2 2024年4月16日公表

※3 (営業利益+持分法投資損益-法人税)÷(有利子負債+純資産)

※4 {(借入金+コマーシャルペーパー+社債+リース債務)-現金及び預金-劣後ローン×50%}÷(自己資本+劣後ローン×50%)

劣後ローン(借入金に含まれる)の50%の資本性は、2020年4月27日付ならびに2024年7月29日付の㈱日本格付研究所の格付に基づく

2024年セグメント別売上高・営業利益

RESONAC

(億円)

セグメント	項目	2024年 今回予想 ^{※1}				2023年実績 ^{※2}		2024年 前回予想 ^{※3}	
		1Q実績	2Q実績	上期実績	通期予想	通期実績	増減	通期予想	増減
半導体・電子材料	売上高	975	1,121	2,096	4,330	3,381	949	4,100	230
	営業利益	63	153	216	500	△ 94	594	310	190
	対売上EBITDA _(%)	20.0%	26.0%	23.2%	24.1%	13.0%	11.1p		
モビリティ	売上高	526	555	1,080	2,050	2,161	△ 111	2,100	△ 50
	営業利益	17	7	24	40	54	△ 14	70	△ 30
	対売上EBITDA _(%)	12.9%	11.1%	12.0%	11.7%	11.9%	△ 0.2p		
イノベーション材料	売上高	223	247	470	1,000	930	70	950	50
	営業利益	24	31	55	100	79	21	90	10
	対売上EBITDA _(%)	18.3%	19.4%	18.9%	16.6%	11.9%	△ 0.2p		
ケミカル	売上高	1,168	1,286	2,454	5,350	5,163	187	5,350	-
	営業利益	7	14	20	110	77	33	130	△ 20
	対売上EBITDA _(%)	4.4%	4.9%	4.6%	5.5%	11.9%	△ 0.2p		
その他・調整額	売上高	322	262	585	1,190	1,254	△ 64	1,100	90
	営業利益	△ 22	△ 14	△ 36	△ 140	△ 153	13	△ 130	△ 10
	対売上EBITDA _(%)	2.4%	4.5%	3.4%	△ 2.3%	△ 2.7%	0.5p		
合計	売上高	3,214	3,472	6,685	13,920	12,889	1,031	13,600	320
	営業利益	89	190	280	610	△ 38	648	470	140
	対売上EBITDA _(%)	11.3%	13.7%	12.5%	12.3%	8.2%	4.1p		

Appendix

連結対象会社 (前期末対比)

連結子会社：101社 (△1社)

△1社: 海外子会社清算関連

持分法適用会社：12社 (±0社)

主要諸元

(期中平均)

	2023年		2024年	
	1-6月	通期実績	1-6月	通期予想
為替レート				
(円/US\$)	134.9	140.6	152.2	151.1
	<i>2023年6月 期末レート: 145.0</i>		<i>2024年6月 期末レート: 161.1</i>	
(円/€)	145.8	152.0	164.6	157.3
国産ナフサ (円/KL)	67,000	67,600	75,750	76,900

(億円)

	2023年 1-6月	2024年 1-6月	増減	2023年 通期実績	2024年 通期予想	増減
営業キャッシュ・フロー	481	533	52	1,187	1,140	△ 47
投資キャッシュ・フロー	△ 451	△ 111	341	△ 619	△ 820	△ 201
フリー・キャッシュ・フロー (営業CF + 投資CF)	29	422	393	568	320	△ 248
財務キャッシュ・フロー	△ 235	△ 112	123	△ 629	150	779
その他	100	167	67	99		
現金及び現金同等物 増減額	△ 106	477	583	39		

(億円)

	2023年 1-6月	2024年 1-6月	増減	2023年 通期実績	2024年 通期予想	増減
設備投資	391	460	68	966	1,224	258
減価償却費 (PPA、のれん償却額除く)	378	391	13	766	771	5
PPA償却費	79	81	1	159	160	1
のれん償却額	84	86	2	170	172	3
研究開発費	209	213	4	427	438	11
金融収支	△ 56	△ 51	5	△ 111	△ 117	△ 5

(億円)

セグメント	2023年 1-6月※	2024年 1-6月	増減	2023年 通期実績※	2024年 通期予想	増減
半導体・電子材料	189	231	42	388	641	253
モビリティ	50	59	9	134	114	△ 20
イノベーション材料	18	19	1	44	52	8
ケミカル	80	98	18	232	274	42
その他	53	53	△ 0	169	143	△ 26
合計	391	460	68	966	1,224	258

※アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

セグメント		2023年 1-6月※1	2024年 1-6月	増減	2023年 通期実績※1	2024年 通期予想	増減
半導体・電子材料	減価償却費(PPA除く)	135	142	7	276	286	10
	PPA償却費	62	62	-	124	124	0
	のれん償却額	66	66	△0	133	133	△0
モビリティ	減価償却費(PPA除く)	80	84	4	160	157	△3
	PPA償却費	11	11	-	21	21	0
	のれん償却額	11	11	-	21	21	△0
イノベーション材料	減価償却費(PPA除く)	25	24	△1	49	48	△2
	PPA償却費	5	5	0	9	10	0
	のれん償却額	4	4	0	9	9	0
ケミカル	減価償却費(PPA除く)	84	89	5	169	175	6
	PPA償却費	1	2	1	3	4	1
	のれん償却額	0	2	2	1	3	2
その他	減価償却費(PPA除く)	50	52	2	106	105	△2
	PPA償却費	1	1	-	2	2	0
	のれん償却額	3	3	0	6	6	0
継続事業ベース※2 合計	減価償却費(PPA除く)	374	391	17	762	771	9
	PPA償却費	79	81	1	159	160	1
	のれん償却額	84	86	2	170	172	3
非継続事業	減価償却費(PPA除く)	4	-	△4	4	-	△4
	PPA償却費	-	-	-	-	-	-
	のれん償却額	-	-	-	-	-	-
合計	減価償却費(PPA除く)	378	391	13	766	771	5
	PPA償却費	79	81	1	159	160	1
	のれん償却額	84	86	2	170	172	3

(億円)

※1 アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値
 ※2 事業譲渡した診断薬事業を除いた参考値(監査対象外)

(億円)

項目	2024年 1-3月	2024年 4-6月	増減
売上高	3,214	3,472	258
営業利益	89	190	101
営業外損益	21	4	△ 16
経常利益	110	195	85
特別損益	187	△ 10	△ 197
税金等調整前四半期純利益	297	184	△ 113
四半期純利益	274	110	△ 163
親会社株主に帰属する四半期純利益	271	114	△ 157
EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん等償却費)	363	475	113
対売上EBITDA _(%)	11.3%	13.7%	2.4p

(億円)

セグメント		2023年※1				
		1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	通期実績
半導体・電子材料	売上高	694	840	883	964	3,381
	営業利益	△ 104	△ 27	6	30	△ 94
モビリティ	売上高	518	521	554	567	2,161
	営業利益	3	3	22	26	54
イノベーション材料	売上高	207	229	242	252	930
	営業利益	12	17	26	23	79
ケミカル	売上高	1,271	1,278	1,298	1,316	5,163
	営業利益	39	9	54	△ 25	77
その他	売上高	269	269	285	366	1,189
	営業利益	△ 44	△ 43	△ 20	△ 49	△ 157
継続事業ベース※2 合計	売上高	2,959	3,137	3,262	3,466	12,824
	営業利益	△ 93	△ 42	89	5	△ 41
非継続事業	売上高	30	35	0	0	65
	営業利益	1	2	△ 0	△ 0	4
合計	売上高	2,989	3,172	3,262	3,466	12,889
	営業利益	△ 92	△ 40	89	5	△ 38

※1アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

※2 事業譲渡した診断薬事業を除いた参考値(監査対象外)

セグメント	トピックス
半導体・ 電子材料	シリコンバレーで日米の企業10社による次世代半導体パッケージのコンソーシアム設立
	ハードディスク旧台湾拠点の固定資産譲渡並びに特別利益計上
モビリティ	レゾナック、EV向け高性能ディスクブレーキパッドを開発 高い制動力と耐摩耗性を実現し、2026年量産化を目指す
ケミカル	石油化学事業に関する子会社(分割準備会社)を設立
	レゾナック・丸紅がバイオマス製品事業の協業を開始 ～カーボンニュートラルへ向けたエチレンプラントでのバイオマス原料の活用で持続可能な未来へ～
その他	劣後ローンによる資金調達・既存劣後ローンの期限前弁済に関するお知らせ

ニュースリリース

詳細は各ニュースリリースをご参照ください。

<https://www.resonac.com/jp/news>

注意事項

本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。

なお、法令に定めのある場合を除き、当社はこれらの将来予測に基づく記述を更新する義務を負いません。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、ナフサ等原材料価格、黒鉛電極等製品の需要動向および市況、為替レートなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。